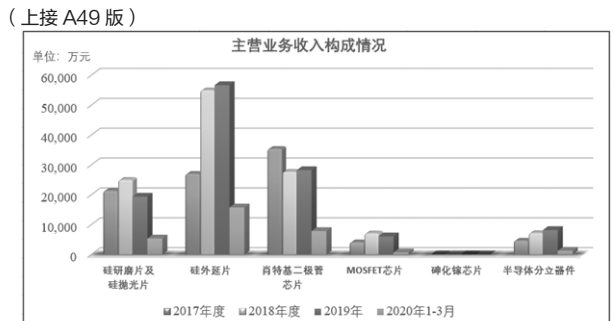


## 杭州立昂微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要



报告期内,公司的产品结构基本保持稳定,主营业务收入的主要来源为半导体硅片中的硅研磨片及硅抛光片、硅外延片以及半导体分立器件芯片中的肖特基二极管芯片,上述产品的销售收入合计占主营业务收入的比例超过90%。2017年起,公司业务延伸至半导体分立器件成品。

### ③主营业务收入按区域分析

区域	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
内销	25,437.69	82,838.96	96,499.54	81,591.95
外销	5,273.56	17,171.21	21,774.49	18,411.77
合计	30,711.25	100,000.00	118,274.03	100,000.00

公司的主要收入来源是国内销售,报告期各期,国内销售收入占主营业务收入比重分别为83.00%、81.23%、81.59%和82.83%。

报告期各期,公司外销收入分别为15,683.49万元、22,842.35万元、21,774.49万元和5,273.56万元,占主营业务收入比重分别为17.00%、18.77%、18.41%和17.17%。公司外销收入主要来自半导体硅片与半导体分立器件芯片的海外销售,报告期内,外销收入占主营业务收入的比例保持稳定,主要销售区域包括新加坡、马来西亚、美国、中国台湾等。

### ④其他业务收入分析

报告期内,公司其他业务收入发生额较少,主要包括金属及材料销售、子公司立昂半导体设备销售等收入。各项收入的金构成情况如下:

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
金属及材料	221.40	889.18	587.53	769.82
设备	0.11	-	-	100.36
其他	-	5.39	5.83	51.79
合计	221.52	894.57	593.36	921.97

### (2)公司利润的主要来源

报告期内公司营业利润和利润总额比例关系如下表所示:

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
营业利润	25,437.69	82,838.96	96,499.54	81,591.95
利润总额	25,437.69	82,838.96	96,499.54	81,591.95

报告期各期,营业利润占公司利润总额的比例分别为98.21%、99.31%、98.44%和99.97%,公司利润主要来源于营业利润。

### ①综合毛利情况

报告期内公司综合毛利情况如下:

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
主营业务	11,493.57	99,928.96	114,303.07	99,633.01
其他业务	9.24	0.08	163.69	0.37
合计	11,502.81	100,000.00	114,466.75	100,000.00

报告期内,公司的主营业务突出,主营业务产生的毛利占比均在97%以上,其他业务对公司综合毛利的贡献较小。

### ②主营业务主要产品的毛利贡献分析

报告期内,公司主要产品的毛利及贡献率情况如下:

产品类型	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
半导体硅片	8,766.96	76,288.36	81,644.37	81,591.95
其中:硅抛光片及硅研磨片	2,090.62	18,191.96	7,889.78	17,811.11
硅外延片	6,676.33	58,096.40	73,754.59	63,780.84
半导体分立器件芯片	2,439.92	21,236.40	7,000.52	15,355.14
其中:肖特基二极管芯片	2,464.72	21,448.88	7,676.74	15,588.91
MOSFET芯片	-24.81	-0.22%	77.47	-0.49%
碳化硅芯片	9.29	0.08%	-281.40	-0.64%
半导体分立器件成品	277.40	2,411.04	1,817.63	4,105.13
合计	11,493.57	100,000.00	114,466.75	100,000.00

报告期内,对公司主营业务的毛利贡献最高的产品是肖特基二极管芯片和硅外延片,报告期各期,肖特基二极管芯片对毛利的贡献率为54.23%、20.15%、19.58%和21.44%,硅外延片对毛利的贡献率为31.95%、62.45%、63.83%和58.09%,两者毛利贡献率之和超过80%。2017年及2018年,国内半导体市场硅外延片热度较高,硅外延片处于供不应求状态,销量大幅增长;而2018年公司肖特基二极管芯片销量则有所下滑,因此当年度硅外延片对毛利的贡献率上升而肖特基二极管芯片对毛利的贡献率下降。2019年,各产品对毛利的贡献率与2018年度相比较为稳定。报告期内,硅抛光片及硅研磨片对毛利的贡献率在18%左右,受其他主要产品销售规模影响略有波动。报告期内,MOSFET芯片对毛利的贡献率持续为负,主要是由于MOSFET芯片尚未达到盈亏平衡所致。

### (3)毛利率分析

公司报告期内毛利率情况如下表所示:

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
主营业务	37.42%	99.28%	37.46%	99.25%
其他业务	4.17%	0.72%	18.30%	0.75%
合计	37.93%	100.00%	37.31%	99.98%

报告期各期,公司的综合毛利率分别为29.98%、37.69%、37.31%和37.19%,由于公司的产品线丰富,产品种类多,多种产品的市场占有率位于行业前列,因此公司拥有较强的市场抗风险能力,综合毛利率较为稳定。

### ①主营业务毛利率变动趋势分析

产品类型	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
半导体硅片	41.67%	-5.95%	47.63%	1.08%
半导体分立器件芯片	28.81%	9.50%	19.33%	-0.87%
肖特基二极管芯片	100.00%	264.80%	254.30%	54.80%
半导体分立器件成品	23.20%	0.89%	22.30%	20.10%
合计	37.42%	0.03%	37.46%	-0.02%

2018年公司主营业务毛利率较2017年上升7.87%,一是由于半导体硅片自2017年起市场热度较高,销售价格供求关系影响呈上升趋势;二是公司2017年开始8英寸半导体硅片产品产销量增加明显,已形成一定的规模效应,单位硅片成本进一步降低。

2019年,公司主营业务毛利率与上年度基本持平,其中半导体硅片产品毛利率上升1.08%,半导体分立器件芯片产品毛利率下降0.87%,另外半导体分立器件成品的毛利率上升2.20%。2019年,公司碳化硅芯片的毛利率为负,主要系该产品的生产线于2019年上半年转固,公司向客户样品进行测试、量产前的准备阶段,2019年度实现销售收入较少,固定成本较大所致。

2020年1-3月,公司主营业务毛利率与上年度基本持平,其中半导体硅片产品毛利率下降5.95%,而半导体分立器件芯片产品毛利率上升9.50%,另外半导体分立器件成品的毛利率上升1.08%。

### ②主营业务毛利率按产品分类分析

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
硅抛光片及硅研磨片	17.35%	39.23%	61.81%	40.83%
硅外延片	51.15%	42.50%	24.74%	47.87%
肖特基二极管芯片	25.42%	31.57%	80.03%	20.80%
MOSFET芯片	2.15%	-3.75%	-0.08%	5.07%
碳化硅芯片	0.03%	100.00%	0.03%	0.01%
半导体分立器件成品	3.89%	23.20%	0.90%	6.89%
合计	100.00%	37.42%	37.42%	37.46%

报告期内,对公司利润贡献较大的产品包括硅抛光片及硅研磨片、硅外延片、肖特基二极管芯片,其中半导体硅片产品毛利率在2018年度大幅上升而自2019年起有所下滑;肖特基二极管芯片毛利率在经历2018年及2019年的持续下滑后,于2020年1-3月略有回升;MOSFET芯片的负毛利情况在2018年度有所改善,2020年1-3月本期销售的MOSFET芯片主要为年末未计提跌价准备的库存商品,导致本期结转的单位成本大幅下降,故毛利率情况改善较为明显;肖特基二极管的毛利率波动较大。

### ③与可比上市公司综合毛利率比较分析

证券代码	证券简称	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
600360.SH	华微电子	17.13%	19.53%	22.72%	20.70%
600460.SH	士兰微	20.35%	18.82%	25.46%	26.70%
300753.SZ	扬杰科技	30.42%	29.31%	31.36%	35.58%
2481.TW	强盛	19.81%	21.02%	22.33%	22.35%
002129.SZ	中环股份	19.63%	19.13%	17.35%	13.89%
3016.TW	晶品	6.69%	6.37%	17.02%	19.87%
6182.TW	合晶	23.72%	34.68%	37.10%	23.98%
行业平均		19.28%	21.27%	24.70%	23.29%
本公司		38.17%	37.31%	37.69%	29.98%

数据来源:Wind 资讯及上市公司公开披露资料。

报告期内,公司综合毛利率水平高于可比上市公司平均水平,主要是由于产品结构不同所致。公司产品包括半导体硅片、分立器件芯片及分立器件成品,而可比上市公司华微电子、士兰微、扬杰科技均为集半导体芯片与功率二极管制造、封装测试等业务于一身的综合型半导体企业,强茂的主要产品为整流二极管、功率半导体、突波抑制器等分立器件产品,中环股份的主要产品为新能源行业太阳能级硅片,晶品主要产品为半导体硅外延片,合晶的主要产品为半导体硅外延片与硅抛光片。

### 3.现金流量分析

报告期内,公司现金流量构成情况如下:

项目	2020年1-3月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量净额	2,420.17	38,333.01	37,364.38	9,496.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,108.60	-108,410.37	-73,457.23	-51,823.95
筹资活动产生的现金流量净额	14,843.53	39,151.73	91,797.93	56,862.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	13.12	-485.18	37.10	-92.21
现金及现金等价物净增加额	168.22	-31,410.81	55,741.67	14,421.11

### 4.财务状况和盈利能力的未来趋势分析

#### (1)财务状况趋势分析

截至2020年3月31日,公司合并报表口径的资产规模为487,648.68万元,净资产为199,718.94万元,资产负债率为59.04%。公司资产结构中货币资金、应收账款、存货、固定资产及在建工程为主,主要客户为国内外知名半导体企业,应收账款与存货的周转情况较好,固定资产及在建工程主要为生产所需房屋及设备,公司资产质量良好。负债结构中以银行借款与应付账款为主,公司目前融资渠道较少,超出自有资金以外的业务发展所需资金主要通过银行借款解决,在一定程度上增加了公司偿债风险,影响了公司财务状况。

若本次发行成功募集资金到位后,公司的总资产和净资产将大幅增加,公司财务结构将得到优化,资产负债率将有所下降,公司资产结构将更加合理,财务状况将得到进一步改善,有利于公司扩大生产规模,增加市场占有率,提升市场竞争力。

#### (2)盈利能力趋势分析

报告期内,公司主营业务突出,各期的主营业务收入占比均在98%以上。报告期各期公司分别实现营业收入93,201.96万元、122,266.70万元、119,168.60万元和30,932.77万元,实现归属于母公司股东的净利润分别为10,561.05万元、18,075.98万元、12,818.79万元和3,247.68万元,营业收入规模在2018年度实现大幅增长后保持相对平稳,而归属于母公司股东的净利润在2019年度受相关费用支出增加的影响有所下降。总体来看,公司仍具备较强的盈利能力。

公司所处半导体行业是我国重点鼓励、扶持发展的产业。随着制造强国战略的提出,作为振兴民族半导体工业、促进国民经济转型的重要一环,各部门通过制定产业政策 and 颁布法律法规,从鼓励产业发展、支持研究开发、加强人才培养、知识产权保护等方面,对半导体产业发展给予大力支持,产业发展前景良好。

公司作为国内半导体行业特别是半导体硅片行业的领先企业,具备较强的技术研发实力和项目实施经验,经过多年的经营,公司已具有较高的行业地位及较强的行业影响力,与国内外多家知名半导体企业建立了长期稳定的业务合作关系,业务基础稳固。

随着本次募集资金的到位以及募投项目的实施,公司的产品产能和经营业绩将得到大幅提升,包括大尺寸半导体硅片在内的产品开发及生产能力、创新能力亦将得以提升,公司的盈利水平也将相应上升,从而进一步巩固并提升公司在半导体硅片及分立器件行业的综合竞争力,并增强公司抵御市场风险的能力。

### (五)股利分配政策

#### 1.现行股利分配政策

##### (1)立昂微电子现行的股利分配政策

公司现行的股利分配政策如下:  
1)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

2)公司的公积金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

##### (2)浙江金瑞泓现行的股利分配政策

浙江金瑞泓现行的股利分配政策如下:

1)公司的税后利润按以下顺序分配:

①弥补上年度亏损(当公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损时);

②提取法定公积金(税后利润的10%);

③支付全体普通股股利。

2)公司法定公积金累计达到注册资本的百分之五十不再提取,公司在从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,可以提取任意公积金;任意公积金的提取比例,由董事会根据公司经营状况提出建议。

3)公司股利和红利分配一致,如需要变更分配比例,由股东大会作出决定,股利采取现金或送股形式分配。公司按照《公司法》及有关法律、行政法规规定弥补亏损和提取法定公积金后所余利润,按照股东出资比例分配给股东。在公司盈利年度,公司当年分配给股东的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

##### (3)衢州金瑞泓现行的股利分配政策

衢州金瑞泓现行的股利分配政策如下:

公司按照《公司法》及有关法律、行政法规规定弥补亏损和提取法定公积金后所余利润,按照股东出资比例分配给股东。在公司盈利年度,公司当年分配给股东的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

##### (4)立昂东芯现行的股利分配政策

立昂东芯现行的股利分配政策如下:

公司按照《公司法》及有关法律、行政法规规定弥补亏损和提取法定公积金后所余利润,按照股东出资比例分配给股东。在公司盈利年度,公司当年分配给股东的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

### 2.报告期内股利分配情况

2017年5月31日,经公司2016年年度股东大会审议通过,决定以截至2016年末的可供分配利润为基础,向全体股东派发现金股利4,320万元(税前)。

2017年6月8日,经公司2017年年度股东大会审议通过,决定以截至2017年末的可供分配利润为基础,向全体股东派发现金股利4,320万元(税前)。

2019年3月22日,经公司2018年年度股东大会审议通过,决定以截至2018年末的可供分配利润为基础,向全体股东派发现金股利5,040万元(税前)。

2020年5月15日,经公司2019年年度股东大会审议通过,决定以截至2019年末的可供分配利润为基础,向全体股东派发现金股利1,800万元(税前)。

### 3.本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司2018年度第一次临时股东大会决议,公司首次公开发行股票时点滚存的未分配利润由公开发行股票后的新老股东按持股比例共同享有。

### 4.发行上市后的股利分配政策

详见本招股意向书摘要之“第一节 重大事项提示”之“九、公司发行上市后的股利分配政策”。

### (六)发行人控股子公司情况

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有5家控股子公司,分别为浙江金瑞泓、立昂半导体、立昂东芯、衢州金瑞泓、金瑞泓微电子;3家参股合伙企业,分别为绿发农银(含并报表范围内)、绿发金瑞泓、绿发立昂。报告期内,公司原全资子公司立昂半导体已于2017年11月被浙江金瑞泓吸收合并,发行人子公司(含已注销子公司)历史上不存在承接国有或集体企业资产、人员、技术的情形。各企业的具体情况如下:

#### 1.浙江金瑞泓

企业名称	浙江金瑞泓科技股份有限公司
统一社会信用代码	9133020702492620
成立时间	2006年6月21日
注册资本	24,236万元
实收资本	24,236万元
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人	王敏文
注册地和主要经营地	宁波保税区0125-3号楼
经营范围	一般项目:新材料、化合物半导体材料、人工晶体材料、复合半导体材料及半导体器件的研发、生产、销售;集成电路设计、数据通信、计算机软硬件技术开发;电子技术工程项目的技术咨询、服务;高科技项目的技术研究开发;技术咨询、服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主营业务	半导体硅片的研发、生产和销售
股权结构	立昂微电子 21,445.27 88.49% 立昂半导体 10.73 0.04% 国投创业 2,780.00 11.47% 合计 24,236.00 100.00%

主要财务数据(经中汇审计,单位:万元):

项目	2020-3-31/2020年一季度	2019-12-31/2019年度
资产合计	326,394.40	307,687.70
负债合计	135,177.67	122,651.46
所有者权益合计	191,216.73	185,036.25
营业收入	29,227.48	111,396.87
净利润	6,157.35	21,189.90

#### 2.立昂半导体

企业名称	杭州立昂半导体技术有限公司
统一社会信用代码	91330101088854229B
成立时间	2013年12月19日
注册资本	500万元
实收资本	500万元
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	王敏文
注册地和主要经营地	杭州经济技术开发区白杨街道金沙9幢1110室
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务、半导体材料、半导体芯片、半导体封装与测试、半导体器件的研发、生产、销售;半导体器件的研发、生产、销售;电子技术工程项目的技术咨询、服务;高科技项目的技术研究开发;技术咨询、服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主营业务	半导体专用器件及设备的销售。
股权结构	立昂微电子 500 100%

主要财务数据(经中汇审计,单位:万元):

项目	2020-3-31/2020年一季度	2019-12-31/2019年度
资产合计	5,759.38	4,293.98
负债合计	5,374.92	3,837.68
所有者权益合计	384.46	456.30
营业收入	3,807.20	10,190.11
净利润	-71.84	57.96

#### 3.立昂东芯

企业名称	杭州立昂东芯微电子有限公司
统一社会信用代码	91330101MA27WBYG98
成立时间	2015年11月26日
注册资本	10,497.72万元
实收资本	10,497.72万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	王敏文
注册地和主要经营地	杭州经济技术开发区20号大街199号1-5幢
经营范围	一般项目:集成电路设计、电子产品、机电设备及配件、计算机软硬件及配件、技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;集成电路及半导体器件、货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。
主营业务	从事碳化硅衬底(GaN RFIC)芯片的研发、生产和销售。
股权结构	立昂微电子 9,995,000.00 95.21% 绿发农银 398,1